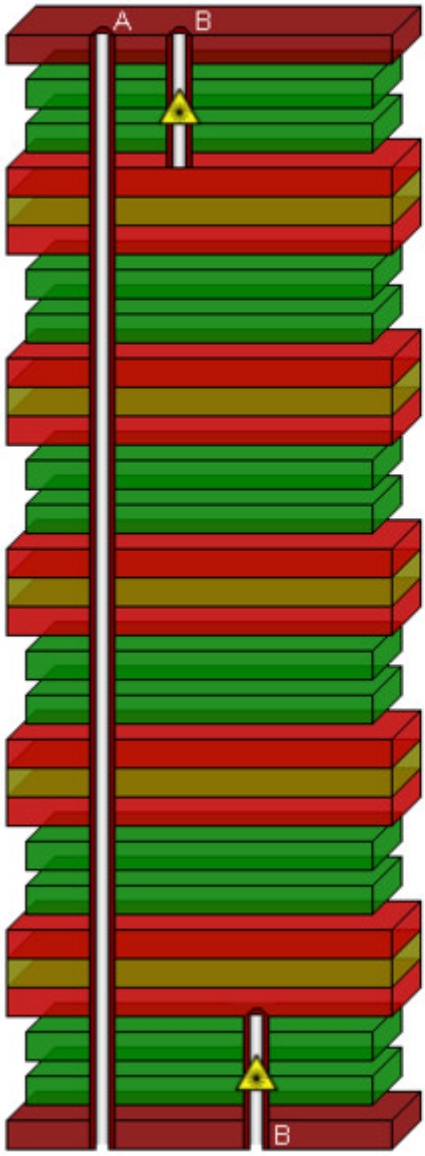
Multilayer 12 Lagen - 1,5/1,6 mm - Microvia

Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
		Cu+galv.Cu		18+25	
1		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		35	
2		Tr-Lam	0.10		
		Cu		35	
3		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		35	
4		Tr-Lam	0.10		
		Cu		35	
5		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		35	
6		Tr-Lam	0.10		
		Cu		35	
7		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		35	
8		Tr-Lam	0.10		
		Cu		35	
9		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu		35	
10		Tr-Lam	0.10		
		Cu		35	
11		Prepreg	0.048		106
		Prepreg	0.048		106
		Cu+galv.Cu		18+25	
12					

Presslingsdicke *	1,40	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	1,51	+/- 10%

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Multilayer 12 Lagen - 1,5/1,6 mm - Microvia

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Lasersacklöcher [B] (blind Vias)	End-Ø	≥ 100 µm
	Viapad-Ø	≥ 350 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥120 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com